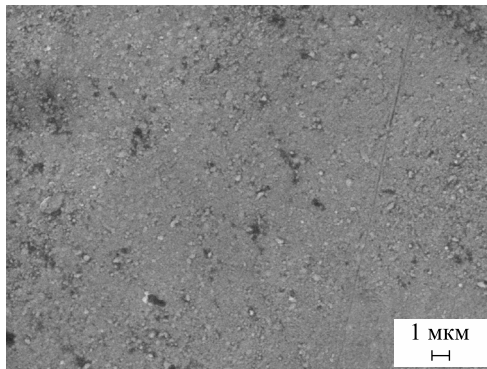


a/a



б/б

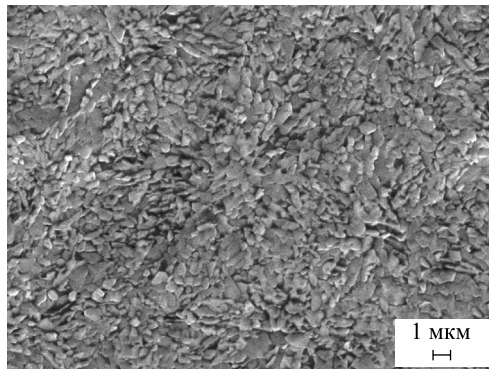


Рис. 3. Микроструктура покрытий Cu – Sn, прогретых при температуре 250 °С (*а*) и 400 °С (*б*) в течение 2 ч.
Содержание меди: *а* – 70 мас. %, *б* – 80 мас. %

Fig. 3. Microstructure of Cu – Sn coatings heated at temperature 250 °C (*a*) and 400 °C (*b*) for 2 h.
Copper content: *a* – 70 wt. %, *b* – 80 wt. %